

## 长芯半导体

长芯半导体有限公司正式成立于2017年，致力于为全球中小型半导体企业及硬件厂商提供半导体设计及封装测试服务。生产基地总投资 5.25 亿元，第一期投资 1.5 亿元，占地8000平米，拥有SIP封装工艺生产设备及测试设备，年产能60KK。

一站式对接1000家IC设计公司和50家主流供应商，服务企业的MPW、NTO、小规模量产、封装以及测试需求。

通过提升运营效率，满足客户的产能需求，降低成本。Longcore长芯半导体致力于开发一个开放的物联网制造平台。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/zxbdt-352483.html>